

正会員様各位

一般社団法人 日本半導体製造装置協会
会長 辻村 学

『平成 30 年度 正会員講演会・正会員懇親会』のご案内

拝啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は、当協会諸活動に格別のご支援・ご協力を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、当協会では、来る 11 月 22 日(木)に、当協会の正会員相互の親睦を深めることを目的に、正会員講演会と正会員懇親会を開催いたします。正会員相互の懇親或いは情報交換の場としてご活用いただければ誠に幸いです。

ご多用中とは存じますが、ご参加を賜りたく、宜しくお願い申し上げます。

敬 具

日時：平成 30 年 11 月 22 日(木)

場所：如水会館

東京都千代田区一ツ橋 2-1-1 <http://www.kaikan.co.jp/josui>

TEL 03(3261)1101

正会員講演会 17:00 ~ 18:00

場所：如水会館 3F「富士の間」

演題：『外資 30 年の経験からの挑戦』

講師：石合 信正 様

エイブリック株式会社

代表取締役社長兼 CEO

正会員懇親会 18:00 ~ 19:30(中締め)

場所：如水会館 3F「松風の間」

お申し込み方法

- * お手数ですが、添付の申込書により FAX にてご返信下さい。
- * お申込期限は、11 月 8 日(木)とさせていただきます。

以上

(配布先：正会員代表者、正会員窓口、理事、監事、運営委員、経済産業省)

本件お問い合わせ先：(一社)日本半導体製造装置協会 総務部 久野 TEL:03-3261-8260
e-mail:hisano@seaj.or.jp